

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):



BLACK BORDERS

- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



(19)

(11) Publication number:

6

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 61053485

(51) Int'l. Cl.: C08L 83/04 C08K 3/00 C08I
1/20

(22) Application date: 11.03.86

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: 14.09.87(84) Designated contracting
states:

(71) Applicant: SUMITOMO ELECTRI

(72) Inventor: KOUJIYA SHINZOU
YAMASHITA SHINZO
UEMIYA TAKAFUMI
OSAWA YOSHITAKA
NIWA SHINICHIRO
NISHIMURA AKIRA
SHIBATA YUTAKA

(74) Representative:

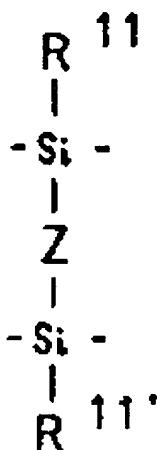
(54) IONIC ELECTRICALLY CONDUCTIVE POLYMER COMPOSITION

(57) Abstract:

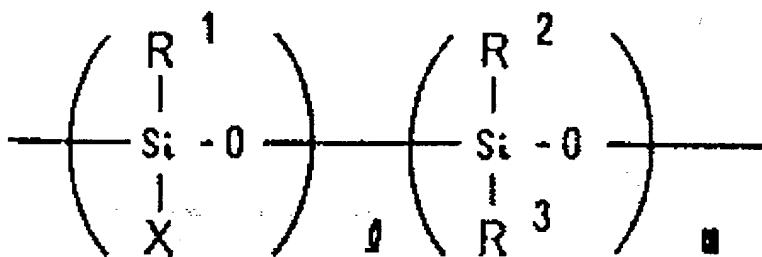
PURPOSE: To obtain the titled composition of high electrical conductivity with outstanding processability, suitable for electronic parts, etc., by dispersion of specific electrolyte in a specific crosslinked polymeric compound.

CONSTITUTION: The objective composition can be obtained by dispersion of (A) group I or II metal ion (e.g. in the form of lithium perchlorate) in (B) a crosslinked polysiloxane cured product with at least its side chain carrying organic group comprising (poly)oxyalkylene group, constituted of structure of formula I (R11 and R11' are each

organic group capable of bonding to silicon atom; Z is crosslink group) in which other section than the crosslinked one is represented by formula II [l is integer; m is 0 or positive number; R₁WR₃ are each organic group capable of bonding to silicon atom; X is organic group comprising (poly)oxyalkylene group]. The component B can be prepared by addition reaction between (1) an organic compound with its crosslink section carrying at least two unsaturated groups and (2) the hydrogenated silicon group in polysiloxane main chain.



COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A) 昭62-209169

⑬ Int. Cl. 4

C 08 L 83/04
C 08 K 3/00
C 08 L 83/12

識別記号

L R X
C A H

庁内整理番号

6609-4J

⑭ 公開 昭和62年(1987)9月14日

※審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

⑮ 発明の名称 イオン導電性高分子組成物

⑯ 特願 昭61-53485

⑰ 出願 昭61(1986)3月11日

⑱ 発明者 柴谷 信三 京都市右京区梅津大堤場町6丁目6番地7-506号
 ⑲ 発明者 山下 晋三 京都市左京区北白川西伊誠町28
 ⑳ 発明者 上宮 崇文 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社
 大阪製作所内
 ㉑ 発明者 大沢 良隆 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社
 大阪製作所内
 ㉒ 発明者 丹羽 真一郎 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社
 大阪製作所内
 ㉓ 出願人 住友電気工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地
 ㉔ 代理人 弁理士 亀井 弘勝 外2名

最終頁に続く

明　　請　　書

1. 発明の名称

イオン導電性高分子組成物

2. 特許請求の範囲

- オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基を少なくとも開鎖に有するポリシロキサンの架橋硬化体と、周辺律環第Ⅰ族または第Ⅱ族の金属イオンからなる電解質とを含むことを特徴とするイオン導電性高分子組成物。
- 架橋部がオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基からなる上記特許請求の範囲第1項記載のイオン導電性高分子組成物。
- オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基が $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-)_n$ (n は正の整数) である上記特許請求の範囲第1項または第2項記載のイオン導電性高分子組成物。
- 架橋部が少なくとも2倍以上の不饱和

基を有する有機化合物と、ポリシロキサン主鎖中の水素化ケイ素基 (MSD) との付加反応によって形成されたものである上記特許請求の範囲第1項記載のイオン導電性高分子組成物。

5. 架橋部が電子顕微鏡によって形成されたものである上記特許請求の範囲第1項記載のイオン導電性高分子組成物。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明はイオン導電性高分子組成物に關し、さらに詳細には、この発明は架橋した高分子化合物に電解質を分散させたイオン導電性高分子組成物に関する。

<従来の技術>

近年、電子部品は高性能化、小型薄型化とともに高信頼性が強く要求されるため、それら電子部品に使用される材料も信頼性の向上を図る必要がある。電池、表示器子等に応用されるイオン導電性材料においても同様の要求を満足させるべく經

持閱啞62-209169(2)

エリザベスが即位を拒んでいた。

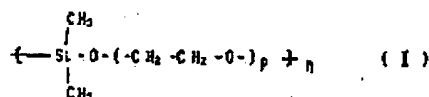
従来、このようなイオン導電性材料としては、(i) 電解質を水、水性溶媒または有機溶媒に溶解した電解質溶液；

(iii) ベータ・アルミニウム ($B - Al_2O_3$) 、窒化リチウム (Li_3N) 、ヨウ化リチウム-アルミニウム ($LiAl - Al_2O_3$) 、ヨウ化銀ルビタウム等の無機質からなる固体電離質材料：
等が知られている。

＜発明が解決しようとする問題点

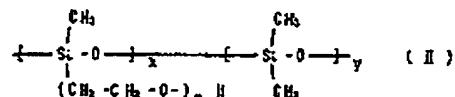
しかし、前述の(I)の鉛層質溶液は本または有機溶剤を使用しているので、電子部品外への腐食という問題が常に存在し、この腐食による導体の性能劣化や周辺部品の損傷を引き起こすことがある。この問題点を改善するために電解質溶液中に高分子物質を添加しゲル状にしたものも知られているが、この材料にしても腐食の危険性を完全に払拭できるものではなかった。

一方、(ii)の固体電解質は、本質的に過電位性をもつて反応の電子部品に適用でき、かつ小型



金属性イオンを含有させてイオン導電性材料としたもの（特開昭60-217263号および特開昭60-216463号参照）；

② ポリエチレンオキシドを固相に有するポリシリコキサン(下記一般式-1)を2官能性イソシアネートにより架橋固化し、



金属イオンを含有させてイオン導電性材料としたもの〔ソリド　ステート　イオニクス (Solid State Ionics) 15 (1985), 233-240 参照〕：

競が斐はらねえ。

しかしながら、上記例にあっては、主鎖中に含まれる -S- と -C- 結合が水の存在により容易に切断されるため、なじとしての吸収が極めて不確

および骨格化できる材料であるが、現状では空洞で充分な堅密性を示す材料が得られておらず、広く应用されるには至っていない。

上記の現状に鑑み、加工性に優れかつ高い導電性を示す高分子のイオン導電性材料が注目されている。高分子のイオン導電性材料において、高い導電性を得るには、それに含有される電解質をイオンに解離させる能力が大きいこと、およびそのイオンが高分子中を容易に移動しやすいことが必要である。このため、高分子イオン導電性材料として、イオン解離能の大きいポリエーテル系の材料が検討されたが、分子運動性の面で課題があり、導電率があまりよくならない欠点があった。この欠点を改善すべく、分子運動性の優れて高いシロキサンとポリエーテルとを組合せた高分子イオン導電材料が提案されている。

そのような例として、例えば、

II シロキサンとポリエチレンオキシドとの共重合体(下記一般式-1)を聚結固化され

ある。また、上記図にあっては、側鎖のポリエチレンオキシド基が架橋に使用されているので、ポリエチレンオキシド部分の運動性が低下し、移動率が整備で高々 10^{-6} S/度のオーダーにしかならない欠点がある。

大同府志

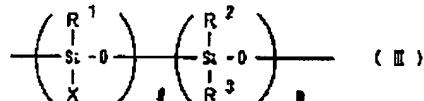
この発明は上記側面点に着めてなされたものであり、側面のオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基の運動性を保たずして架橋されたポリシロキサン架橋体により、高いイオン導電性を有するイオン導電性高分子化合物を提供することを目的とする。

八指虎

上記目的を達成するためになされた、この発明のイオン導電性高分子組成物は、オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基を少なくとも一部に有するポリシロキサンの環状高化体と、周間律系基Ⅰ基または第Ⅱ族の金属イオンからなる溶解性とを含むことを特徴とするものである。

特開昭62-209169(3)

上記の構成において、ポリシロキサン架橋硬化体の架橋部分以外の部分の構造は、下記の一般式一覧で示される。

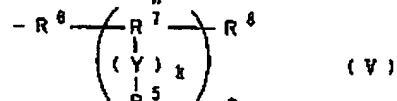


[式中、 \oplus は正の並び、 \ominus は0または正の倍数、 R^1 、 R^2 および R^3 はケイ素原子と結合しうる有機基、Xはオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基を示す。]

上記の一般式-IIIにおいて、ケイ素原子と結合しうる R^1 、 R^2 および R^3 の基としては、メチル、エチル、アロビル、ブチル、ベンチル、ヘキシル、オクチル等のアルキル基、メトキシ、エトキシ、アロボキシ、ブトキシ、ヘキシルオキシ、オクチルオキシ等のアルコキシ基、フェニル、ナフチル等のアリール基を示す。

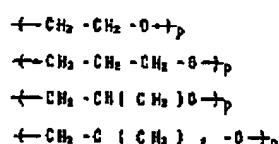
また、Xで示されるオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基は、さらに詳説には下記の一般式-IVまたは一般式-Vで

示される。



[式中、 \oplus および \ominus は正の並び、Yはオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基、 R^4 はケイ素原子と基Yとを結ぶ化学結合基、 R^5 は基Yと結合しうる有機基、 R^6 はケイ素原子と基 R^7 と結合しうる有機基、 R^7 は基Y、基 R^6 および基 R^8 と結合しうる有機基、 R^8 は基 R^7 と結合しうる有機基をそれぞれ意味する。]

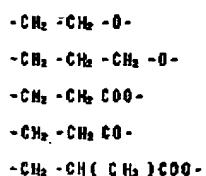
上記の一般式-IVまたは一般式-Vにおいて、基Yで示されるオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基としては、例えば、



[式中、pは正の並びを意味する。]

等が示す。

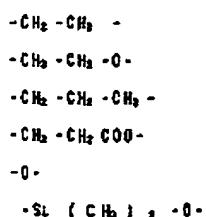
また、ケイ素原子と基Yとを結ぶ化学結合基である R^4 としては、例えば、



等が示す。

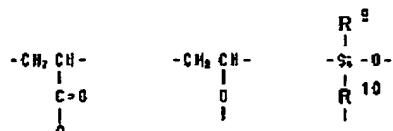
基Yと結合しうる有機基である R^5 としては、例えば、水素原子、前記のアルキル基等が挙げられる。

ケイ素原子と基 R^7 とを結ぶ化学結合基である R^6 としては、例えば、



等が示す。

基Y、基 R^6 および基 R^8 と結合しうる有機基である R^7 としては、例えば、



[式中、 R^9 はケイ素原子と結合しうる有機基、 R^{10} はケイ素原子と基Yとを結ぶ化学結合基を意味する。]

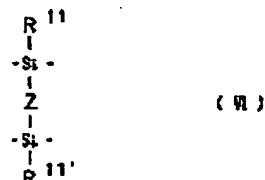
上記の基 R^7 の説明において、ケイ素原子と結合しうる有機基である R^9 としては、前記の R^1 で例示したのと同様な基が挙げられる。また、ケイ素原子と基Yとを結ぶ化学結合基である R^{10} としては、メチレン、エチレン、アロビレン、トリメチレン、テトラメチレン、ベンタメチレン、ヘキサメチレン等のアルキレン基が示す。

基 R^7 と結合しうる有機基である R^8 としては、例えば、水素原子、前記のアルキル基、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリ

特開昭62-209169(4)

ル、トリメトキシシリル等の有機ケイ素化合物等が開示で見る。

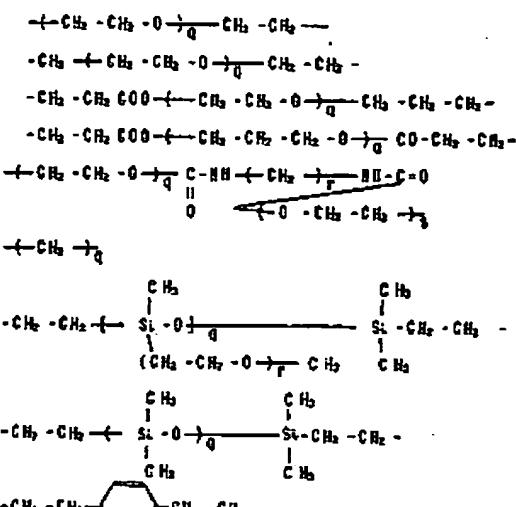
次に、この発明のポリシロキサン架橋硬化体の架橋部分の構造は、下記の一形式一例で示される。



(其中、R¹¹およびR^{11'}はケイ素原子と結合しうる有機基、Zは架橋結合基を意味する。)

ケイ京葉子と結合しうる有機基であるR¹¹およびR¹²としては、前記のR¹で表示したのと同様な基が挙げられる。

また、聚醚縮合基であるZとしては、炭化水素基、オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を含有する有機基、ポリシロキサン基团を有する有機基等が例示でき、これらの基はイミノ基、フェニレン基、カルボニル基等を含んでいてもよい。さらに基Zを具体的に説明すると、



[式中、 α 、 β および γ はそれぞれ正の整数を表すとする。]

この発明のポリシロキサン発展硬化体は、既々の方法で合成することができる。例えば、
合成法-1

不飽和結合およびオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機化合物と水素化ケイ素を有するポリシロキサンとの付加反応を行った後(第1工程)、導入した側鎖の官能基の種類に応じて、該官能基と反応しえる反応性を2回以上含む架橋剤により側鎖の一部を架橋する(第2工程)方法。

上記第1工程の反応は、通常、液塩中で行われる。諸説としては、この反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば何れの溶媒も使用でき、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、臭化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類が挙げられる。

この反応は、触媒の存在下に行うのが好ましい。触媒としては、塩化白金酸が好ましいが、その他のヒドロシリル化反応に通用の触媒、例えば、同用は表第2表に示す移金試薬体、遷移性化合物等も使用できる。また出発原料である不飽和化合物の重合

を防止するためハイドロキノン等の並合禁止剤を追加するのが用ましい。

反応温度は特に規定されないが、通常、室温ないし加熱下に行われる。

上記の第2工程の反応は、上記第1工程で得られたシロキサンポリマーと架橋剤とを溶液の存在下または非存在下に反応させることにより行われる。ここで使用される溶媒としては、前記第1工程で開発された溶媒と同様な溶媒が選ばれる。

架橋剤としては、ポリシロキサンに導入された側鎖上の官能基の種類により適宜選択されるが、例えば、導入された側鎖の本塩基であるオキシアルキレンまたはポリオキシアルキレン基を有する有機塩基の場合、架橋剤としては、例えば、イソシアネート基、カルボキシ基、カルボン酸類水物、カルボン酸ヘライド基、エボキシ基、水酸基、ハライド基、ビニル基、アルキロールアミド基、シラノール基、アルコキシシラン類等の官能基を2以上含有する化合物、またはホウ酸、オルトリシン酸ジエステル、ケタール化合物などが例示

特開昭62-200169(5)

される。なお、樹脂上の官能基と使用できる架橋剤との関係に関しては、「架橋剤ハンドブック」(大成社発行)に詳述されており、これを参照できる。

架橋度の調整は、前記の架橋剤の量を調整する方法、上記第1工程において、架橋剤と反応するタイプの樹脂と反応しないタイプの樹脂の2種類を割合として導入し、その導入量比を適宜調整することにより架橋度を調整する方法等が挙げられる。

この架橋反応の反応温度は、特に設定されないが、通常、冷却下ないし加熱下に行われる。また、架橋剤の種類によっては、トリエチルアミン、ビリウム等の堿基性物質を導入するのが好ましい。

合成法-2

不飽和結合およびオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機化合物ならびに少なくとも2個の不飽和結合を有する有機化合物と水素化ケイ素を有するポリシロキサンとの付加反応を行い、オキシアルキレン基またはポリオ

キシアルキレン基を有する有機基の側鎖への導入と架橋反応を同時にを行う方法。

この反応は前記の合成法-1の第1工程の反応と実質的に同様に行なうことができる。使用される溶媒、触媒、反応温度等は合成法-1の第1工程に記述された説明を参照できる。

合成法-3

本素化ケイ素を有するポリシロキサンと、試水素化ケイ素の当量より少ない量の不飽和結合およびオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機化合物との付加反応を行なう後(第1工程)、導入されたポリマー中の水素化ケイ素基を加水分解し(第2工程)、ヨウ素-0-シリカ結合により架橋する方法。

この反応の第1工程は、前記の合成法-1の第1工程の反応と実質的に同様に行なうことができる。使用される溶媒、触媒、反応温度等は合成法-1の第1工程に記述された説明を参照できる。

第2工程の反応は、水の存在下、ポリマーを加熱することにより行なうことができるが、フィルム

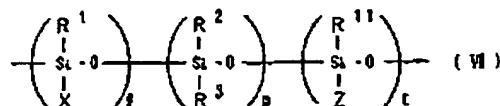
等に成形された該ポリマーを大気中で加熱することによっても行なうことができる。

合成法-4

前記合成法-1の第1工程で得られた、オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基を側鎖に有するポリシロキサンに放電線を照射し架橋させる方法。

この反応で使用される放電線としては、電子線、X線、ガンマ線等が例示できるが、電子線が好ましい。照射線量は特に設定されないが、通常、1~50Mrad程度で行われる。

上記の合成法-1および2で得られるポリシロキサン架橋化体の構造は下記の一般式-1式で示される。



[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^{11} 、 X および Z はそれぞれ前記と同様]

上記の一般式-1式において、 R^1 の部分は

$$\text{J} / (\text{J} + \text{K} + \text{L}) \approx 0.1$$

となることが好ましい。

この発明で使用される周波数表第I級または第II級の金属イオンからなる電解質としては、從来からイオン導電性高分子材料の電解質として使用されている電解質が使用でき、例えは、過塩素酸リチウム、チオシアニ酸リチウム、ホウフッ化リチウム、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム等のリチウム塩、トリフルオロ酢酸ナトリウム、ホウフッ化ナトリウム等のナトリウム塩、トリフルオロメタンスルホン酸カリウム、チオシアニ酸カリウム等のカリウム塩、ヨウ化パリウム等のパリウム塩などの第I級または第II級の金属イオンからなる電解質が例示できる。

この発明のイオン導電性高分子化合物は、前記のポリシロキサンの架橋反応前または後に上記の電解質を添加して製造される。また、所望に応じて、フィルム等に成形される。

さらに、イオン導電性高分子化合物には色々の

特開昭62-209169(6)

ものを添加することが可能である。例えば、ガラス移動点を下げるために、メタノール、テトラヒドロフラン、グリセリン、ポリエチレングリコールなどの有機溶剤を可塑剤として少々添加することも可能である。また、力学的性質に対する要求が厳しい場合には、シリカなどの強化剤を添加することができる。

<作用>

この発明は上記の構成によりなり、電導率の感度を大きくするオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する側鎖が導入されているとともにガラス移動点を下げるポリシロキサン側鎖より構成されるので、電導率の感度を大きくかつイオンの移動度も大きくすることができる。

特に、オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する側鎖の内、架橋に使用されていない側鎖が多く存在するので、該側鎖の運動性が大きく、上記の効果を一層大きくすることができる。

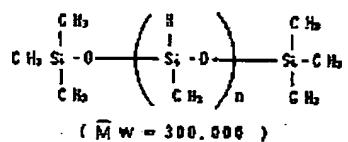
<実施例>

減圧乾燥させた後、白金を電極として25℃での導電率を測定したところ、 $1.3 \times 10^{-5} \text{ S/cm}$ の値が得られた。

化合物①：



化合物②：



実施例2

上記の化合物②0.7g、下記の化合物③1.77g、化合物④0.33gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン32gに溶解し、ここに 3.8×10^{-3} モル/lの塩化白金酸のイソアプロピルアルコール溶液を0.5ml加え、50℃で24時間反応させた。この反応溶液12.7gに、塩酸銀リチウム0.073gのテトラヒドロフラン溶液を加え、充分に混合した後、減圧乾燥し、さらに90℃で3日間真空乾燥して厚さ1

以下、実施例をもって、この発明をより詳細に説明する。

実施例1

下記に示される化合物①1.58g、ポリシロキサン②0.98gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン50gに溶解し、ここに 3.8×10^{-3} モル/lの塩化白金酸のイソアプロピルアルコール溶液を0.5ml加えた後、50℃で24時間反応させた。減圧乾燥によりポリマーを回収した。得られたポリマーの¹H-NMRスペクトルを添附図面に示す。添附図面から明らかのように、化合物①のビニル基に由来するピークは消失し、クイニン環とオキシエチレン基との結合を示すメチレン基のピークがδ = 0.5~2.0 ppmに出現した。

得られたポリマー1.0gと過塩素酸リチウム0.156gをテトラヒドロフランに溶解した後、テフロン製のシャーレ上で乾燥させた。これに、3 MeV の電子線を10 Mrad照射し、1mmの厚さのフィルムを得た。さらに、これを90℃で3日間

減圧乾燥させた後、白金を電極として25℃での導電率を測定したところ $1.6 \times 10^{-5} \text{ S/cm}$ であった。

化合物③：



化合物④：



実施例3

前記化合物②0.9g、化合物③0.43g、化合物④1.305gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン32gに溶解し 3.8×10^{-3} モル/lの塩化白金酸/イソアプロピルアルコール溶液を0.5ml加え、50℃で24時間反応させた。この溶液13.43gと過塩素酸リチウム0.111gを溶解したテトラヒドロフラン溶液とを混合して減圧乾燥させた。この後90℃で24時間真空乾燥を行ないフィルムを得た。30℃での導電率を測定したところ $1.25 \times 10^{-5} \text{ S/cm}$ であった。

実施例4

特開昭62-209169(7)

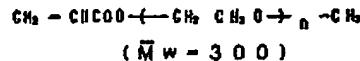
前記化合物④0.98g、化合物⑤0.948gおよびハイドロキノン0.01gをトルエン16.9gに溶解し、 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金酸/イソプロピルアルコール溶液を0.5ml加え、50℃で24時間反応に付した後、減圧乾燥にてポリマーを回収した。このポリマー-1gと過塩素酸リチウムをテトラヒドロフラン溶液に溶解し、80℃の浴液で乾燥させた後、さらに5時間加熱してフィルムを得た。このフィルムを90℃で真空乾燥したところイオン導電性のフィルムが得られた。

実験例5

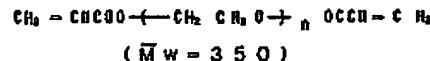
前記化合物④0.23g、化合物⑤0.69g、下記化合物①.09gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン32.9gに溶解し 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金酸/イソプロピルアルコール溶液0.5mlを加え、50℃で24時間反応に付した。この溶液8.83gと過塩素酸リチウムを溶解したテトラヒドロフランを混合した後、減圧にて乾燥し、90℃で3日間真空乾燥をしたところイオン導電性のフィルムが得られた。

化合物①.7gおよびハイドロキノン0.049gをトルエン50gに溶解し、塩化白金酸2.1gの存在下で80℃で8時間反応に付した。この溶液9.3gと過塩素酸リチウムを溶解したテトラヒドロフランを混合し、減圧乾燥し、90℃で3日間真空乾燥を行なったところイオン導電性のフィルムが得られた。

化合物⑥:



化合物⑦:

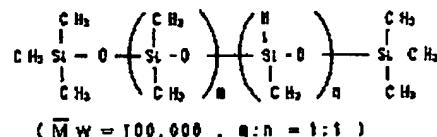


実験例6

前記化合物④0.90g、化合物⑤1.30g、下記化合物⑨0.32gおよびハイドロキノン0.029gをトルエン32.9gに溶解し 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金酸/イソプロピルアルコール溶液を0.5ml加え、50℃で24時間反応に付した。この溶液6.85gと過塩素酸リチウムを

溶解したテトラヒドロフランを混合し、減圧乾燥し、90℃で3日間真空乾燥を行なったところイオン導電性のフィルムが得られた。

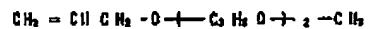
化合物⑧:



実験例6

前記化合物④1.0g、化合物⑤0.519gおよびハイドロキノン0.029gをトルエン32.9gに溶解し 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金酸/イソプロピルアルコール溶液0.5mlを加え、50℃で24時間反応に付した。この溶液8.96gと過塩素酸リチウムを溶解したテトラヒドロフランを混合し、減圧乾燥し、90℃で3日間真空乾燥を行なったところイオン導電性のフィルムが得られた。

化合物⑨:

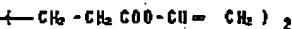


実験例7

前記化合物④1.0g、下記化合物⑩3.3g、

溶解したテトラヒドロフランを混合し、減圧乾燥し、90℃で3日間真空乾燥を行なったところイオン導電性のフィルムが得られた。

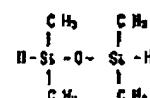
化合物⑩:



実験例8

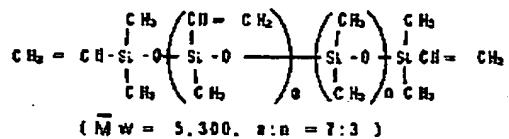
前記化合物④0.78g、下記化合物⑪1.135gおよびハイドロキノン0.048gをトルエン32.9gに溶解し 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金酸/イソプロピルアルコール溶液を0.5ml加え、50℃で12時間反応に付した後、下記化合物⑪1.0gを加え、さらに50℃で24時間反応させた。この溶液を実験例5と同様の処理をしたところイオン導電性のフィルムが得られた。

化合物⑪:



化合物⑪1:

特開昭62-209169(8)



莫純齋 10

前記化合物(11)0.62g、化合物(9)0.91g
およびハイドロキノン0.02gをトルエン16g
に溶解し、 3.8×10^{-3} モル/1の塩化白金
酸/イソプロピルアルコール懸液を0.5滴加え、
50℃で12時間反応に付した後、前記の化合物
(11)1.0gを加え、さらに50℃で24時間反
応させた(反応液(A)と称する)。

一方、化合物III 0.159、化合物IV 0.19
およびハイドロキノン 0.019をトルエン 16
gに溶解し、 3.8×10^{-3} モル/ℓの塩化白金
酸/イソプロピルアルコール溶液を 0.5 滴加え、
50℃で 24 時間反応させた〔反応液 (B) と称
する〕。

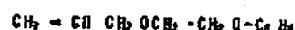
上記の反応波(A)と反応波(B)を混合した後、5.0 mlで24時間反応させた。この溶液を含

従例 5 と同様の処理したところイオン導電性のフィルムが得られた。

黑麻對 11

同記化合物②1, 30 g, 下記化合物(12)2, 14 g, ジビニルベンゼン0, 195 g およびハイドロキノン0, 02 g をトルエン16 g に溶解し、 $3, 8 \times 10^{-3}$ モル/リの塩化白金酸/イソプロピルアルコール混液0, 5 g を加え、50℃で12時間反応に付した。この溶液を実施例5と同様の処理をしたところイオン導電性のフィルムが得られた。

七、化合物(12)：



实施例 12

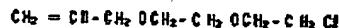
前記化合物(0.50g)、下記化合物(13)4.99g、化合物(14)0.155gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン32gに溶解し、
 3.8×10^{-3} モル/ℓの氯化白金酸/イソアプロピルアルコール溶液0.5mLを加え、50℃で4.8時間反応に付した。この溶液を定容45Lと同様

混合し、一日放置した。さらに反応を完結させるため 90°C で 2 日間真空乾燥したところイオン導電性のフィルムが得られた。

案例別 14

前記化合物②0.90g、化合物Ⅲ1.39g、下記化合物(15)0.25gおよびハイドロキノン0.04gを32gのトルエンに溶解し、3.8×10⁻³モル/1の氯化白金酸ノイソプロピルアルコール溶液を0.5ml混合した後、50℃で24時間反応に付した。この溶液に過塩素酸リチウムを溶解したテトラヒドロフランを混合し、真空乾燥させた後、エチレンジアミンを0.1gを混合し、60℃で5時間反応させたところイオン導電性のフィルムが得られた。

化合物(15):



宋史明了

前記化合物②0.90g、化合物③1.39g、化合物④1.05gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン16gに溶解し3.8×10⁻³

特開昭62-209169(9)

モル/1 の塩化白金銀/イソアロビルアルコール
溶液を0.5g配合し50℃で24時間反応させ
た。この溶液を実施例5と同様の方法で処理した
ところイオン導電性のフィルムが得られた。

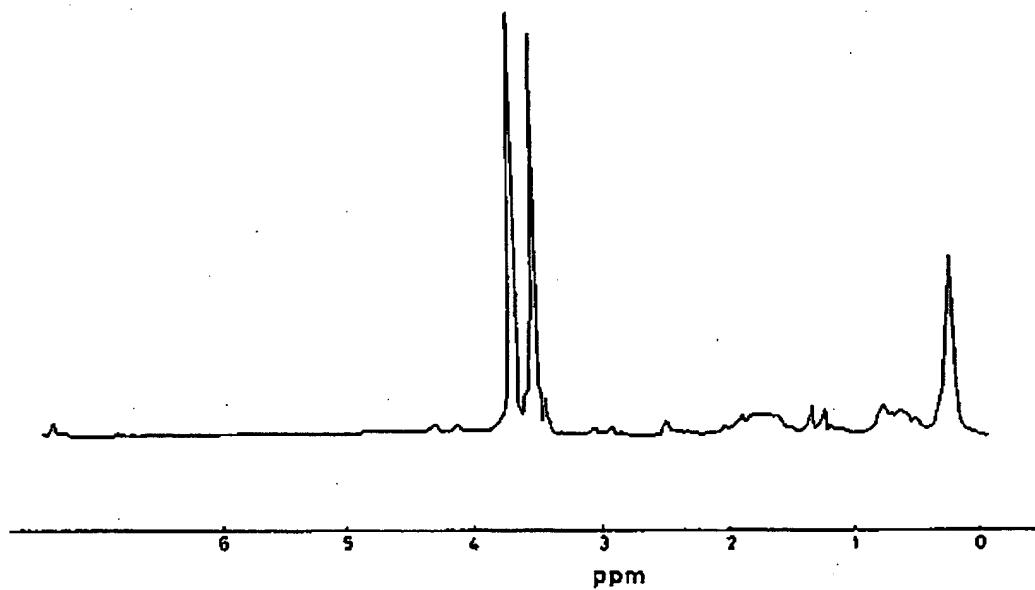
<効用>

以上のように、この発明のイオン導電性高分子
組成物によれば、常温でのイオン導電性が高くか
つフィルム等への成形性が良好なイオン導電性材
料が得られ、さらに固体であるため、電子部品等
に応用した際に発熱等の懸念がないので、高信頼
性の製品が得られるという特有の効用を有する。

4. 図面の簡単な説明

図面は、実施例1で得られたポリマーの
 $^1\text{H-NMR}$ スペクトルを示す図である。

特許出願人 住友電気工業株式会社

代理人 弁理士 亀井 弘継
(ほか2名)

第1頁の続き

⑤InL,Cl,⁴
H 01 B 1/20

識別記号

序内整理番号
Z-8222-5E

⑥発明者 西 村 昭 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社
大阪製作所内

⑦発明者 柴 田 豊 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社
大阪製作所内